

证券代码：301583

证券简称：托伦斯

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司 孟辞 王梓琳 张怡康 山西证券 陈玉卢 中邮证券 翟一梦 盛宇投资 刘江炜 招银理财 赵杰 勤辰资产 江磊 远信投资 杨雅童 华能贵诚信托 孙宇 工银瑞信 谢怡婷 彬元资本 陈海亮 东证资管 贾学展 潘登
时间	2026 年 9 月 3 日上午 9：30-10：40
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理兼首席执行官：钱珂先生 董事、首席财务官兼董事会秘书：许红艳女士 证券事务代表：姜威先生
投资者关系活动主要内容介绍	现场交流环节主要内容如下： 1、公司与中微公司、北方华创两家公司合作的历史背景，以及早期主要合作的产品？ 答：托伦斯 2005 年开始承接中微公司刻蚀设备金属零部件，是最早切入中微供应链的本土零部件厂商之一。2007-2008 年托伦斯启动北方华创供应商准入，早期主要配套北方华创半导体设备的结构件，后续随双方合作深化逐步向高价值工艺零部件、关键工艺零部件升级。 2、公司在北方华创和中微公司中订单分别为多少，在北方华创、中微两家客户中的供应地位如何？ 答：北方华创和中微公司是公司的主要客户，两家客户合计收入占比超过 70%；公司是较早切入北方华创和中微公司的金属零部件供应商，技术能力与交付稳定性得到了客户长期认可。在其精密金属零部件领域属于第一梯队。 3、在手订单如何，交货周期为多久？ 答：目前公司在手订单储备充足。现阶段客户下单后的交付周期基本在 2 个月以内，具体交期会因产品品类、工艺复杂度有所差

异。提请投资者留意，在手订单最终确认收入，会受到产能释放节奏、供应链保障能力等多重因素制约，存在不确定性风险。

4、公司对中长期毛利率怎么看？毛利率能否维持？

答：中长期来看，公司关键工艺零部件的收入占比会逐步提升，这类产品技术门槛高、附加值大，会拉动整体毛利率上行。随着产能释放及工艺成熟度提高，单位固定成本摊薄，叠加良率改善，我们将进一步优化盈利结构。

5、怎么展望行业中长期景气度？

答：行业正步入由 AI 驱动的长景气周期，周期性波动趋于弱化。半导体行业固有的周期性波动会传导至设备及零部件领域。本轮增长的核心驱动力已从传统的消费电子转向人工智能、高性能计算和高端存储。AI 大模型训练与推理对算力的爆发式需求，直接拉动了对先进逻辑制程和高端存储的产能投资。

6、半导体金属零部件的竞争格局如何？公司的核心优势是什么？

答：国际竞争格局方面，全球市场由美、日企业主导，头部企业包括日本 Ferrotec、美国超科林及中国台湾京鼎精密，该等国际巨头凭借技术积累和先发优势，在高端金属零部件市场形成了较高壁垒，通过其长期与国际设备厂商构建的供应链体系，使得其市占率处于较高水平。

国内市场竞争呈现“梯队分化、加速替代”的格局，当前国内半导体设备金属零部件市场主要参与者包括：

第一梯队：以富创精密、先锋精科、托伦斯为代表，具备较为全面的工艺能力和规模化量产实力。该等厂商覆盖半导体工艺零部件和结构零部件，且已进入中微公司、北方华创等头部半导体设备商供应链，建立了长期合作，并且聚焦金属零部件产品，在机械加工、表面处理及焊接工艺领域技术优势突出。

第二梯队：部分具备半导体设备零部件业务的上市公司，聚焦于个别细分产品领域，产品已通过国内主流半导体设备厂、晶圆厂验证。

第三梯队：众多中小型机加工企业，主要从事结构零部件代工，工艺水平较为单一，技术水平相对有限。

公司优势如下：

（1）产品布局全面，特色产品形成差异化优势

公司已搭建起覆盖半导体设备多环节及激光设备领域的完善产品矩阵，并战略聚焦于技术难度大、价值量高的关键工艺零部件。

（2）具备全流程的机加、焊接、表处工艺，尤其是凭借焊接技术为复杂精密零部件奠定技术基础。半导体设备金属零部件的制造涉及多学科、多工艺的复杂集成。

（3）跨领域业务布局增强发展韧性

基于在半导体精密制造领域积累的底层核心技术，公司具备强大的技术迁移与跨领域拓展能力。公司成功将半导体级别工艺技术

	应用至高端工业激光设备领域，为 Lumentum 等国际领先客户提供高功率激光器的腔体及光纤激光器的冷却部件。 7、公司与客户之间的定价机制是怎样的？ 答：公司会综合评估成本、工艺及市场因素进行定价与销售。公司与客户合作的过程中，客户更加重视双方深度技术合作、交付时效与品质保障。 8、激光业务的客户合作情况？ 答：公司在激光业务的主要客户为 Lumentum，公司主要为 Lumentum 提供激光设备的金属零部件，双方保持了长期稳定的合作关系、相关业务规模相对平稳。 9、公司目前有没有与晶圆厂直接合作？ 答：公司专注于为半导体设备、高功率激光器提供精密金属零部件产品，主要客户为半导体设备厂商，公司目前没有与晶圆厂的直接合作。 10、静电卡盘公司做的是哪部分？产品难点在哪里？是标准品还是定制？ 答：公司主要是做静电卡盘基体，静电卡盘基体的工作面需要高平整度，对机加工工艺要求较高。同时，静电卡盘基体内部的多水路、气路和复合孔槽结构对多层钎焊技术要求极高，在钎焊过程中需要精确控制温度、压力和时间等参数，以确保焊接接口处的质量和性能。此外，多层钎焊还涉及复杂的材料匹配和焊接工艺设计，增加了技术难度。 产品针对不同客户需求存在一定差异化特征，产品规格存在客户定制属性。 11、公司在光学零件（量检测、光刻等）方面有布局吗？ 答：我们长期关注半导体高端设备零部件产业链机会，保持持续跟踪与前期技术研判，截至目前，公司暂无该类产品、无对应在手订单，亦未有销售收入，但公司会跟随半导体产业链的发展，不断投入研发资源并开拓新产品和新领域的研究。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 9 月 3 日